	<u> </u>	r	マ	τ Z		
	有机 EL 元件	密封层构成				黑斑产生时间
	黑斑产生时间	电极保护层	缓冲层	干燥工序	气体阻挡层	60℃、90%RH
D	环氧/酸酐	SiON 100nm	环氧	无	SiON 200nm	700 小时以上
	(没有溶剂成分)		10µm			
E	丙烯酸/XDI	SiON 100nm	环氧	减压	SiON 200nm	400~500 小时以
	(溶剂: 醋酸乙酯)		10µm	100Pa		上
				30min		
F	丙烯酸/XDI	SiON 100nm	环氧	减压	SiON 200nm	100~200 小时以
	(溶剂: 醋酸丁酯)		10µm	100Pa		上
	·			30min		
G	无缓冲层	_	_		SiON 200nm	不到 10 小时
	(只有气体阻挡					
	层)					

表 2

(2) 有关黑斑产生时间的实验

表 2 是测定直到产生黑斑所需的时间的实验结果。

评价对象为 $(D) \sim (G)$, 在表 2 中, $(D) \sim (G)$ 分别是指:

- (D)混合无溶剂环氧单体和酸酐系固化剂、反应促进剂进行涂布,并使其固化而形成缓冲层的情况(相当于上述实施方式的制造方法)。
- (E) 由混合了丙烯酸聚合物材料和 XDI(低沸点溶剂: 醋酸乙酯) 的材料形成缓冲层的情况。
- (F) 由混合了丙烯酸聚合物材料和 XDI(低沸点溶剂: 醋酸丁酯) 的材料形成缓冲层的情况。
 - (G) 没有缓冲层的情况。

另外,在(D)~(G)中,形成由氮氧化硅膜(SiON)构成的阴极保护层,形成有由氮氧化硅膜(SiON)构成的气体阻挡层 200nm,作为保护层还形成有带粘合层的聚酰亚胺薄膜。

另外,在(D)中,采用 50Pa 的真空丝网印刷法涂布环氧树脂形成缓冲层且厚度为 10μm。进而,在(D)中,是因为在无溶剂下形成缓冲